

「溶接の新潮流」セミナー

— 話題のキーワードをひもとく —

日時	平成30年11月2日(金) 10:00～15:40	主催	産報出版株式会社
		後援	(一社)日本溶接協会
会場	ステーションコンファレンス万世橋 JR神田万世橋ビル4階 東京都千代田区神田須田町1-25 アクセス: https://www.tstc.jp/manseibashi/access.html	参加費	■参加費: 17,000 円(税別) ■締切日: 10月19日(金)
		定員	■150名

プログラム

3Dプリンター適用の可能性

- 10:00～10:40 「金属ワイヤ溶融・積層方式による3Dプリンタのプロセス解析」
物質・材料研究機構・北野萌一
- 10:45～11:25 「ものづくりを革新する3Dプリンティング技術」
愛知産業・金安 力

IoTによるものづくり

- 11:30～12:15 「IoT利用の革新的造船技術の研究開発」
東京大学・青山和浩

溶接構造物のマルチマテリアル化

- 13:30～14:10 「NEDO/ISMA プロジェクトにおける接合技術の開発動向」
大阪大学・平田好則

VRの実用化へ向けて

- 14:15～14:55 「溶接訓練シミュレータの動向と今後の展望」
大阪大学・浅井 知
- 15:00～15:40 「溶接作業支援システムの開発」
産業技術総合研究所

